

**2025年3月期第2四半期(2024年4月～9月)  
決算説明資料**

**2024年11月11日  
株式会社 KOKUSAI ELECTRIC**

# 注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

## ■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社グループは、適用ある法令又は証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新又は改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるかと認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

## ■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けます。当社グループ製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われておりますが、一部に外貨建売上および費用計上もあり、為替相場の変動により影響を受けることがあります。

## ■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。調整の内容につきましては、決算短信をご参照ください。調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益につきましては、同様または類似の名称を用いている他社の経営指標と内容が異なる場合があります、比較可能性がない場合があります。

## ■ 会計基準について

当社グループは2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

## ■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



# 2025年3月期第2四半期連結決算概要

## 2025年3月期第2四半期連結決算概要

- 生成AIの普及等を背景にDRAMが好調。Logic/Foundryは先端ノード向けの設備投資が増加基調。中国成熟ノード向けの活発な設備投資は落ち着き。
- 2Q累計は前年同期比で増収増益、各利益率も前年同期比で上昇。2Qの前四半期比での減収減益は、1Qへの出荷前倒しが要因。

## 2025年3月期連結業績・配当予想と今後の見通し

- 好調なDRAMに続いてLogic、NANDの回復が進むと想定。
- 当社3Q、4QはDRAM向けを中心に従来予想を上回る見通しとなったことから、通期業績・配当予想を修正。

# 連結業績サマリー

2Q累計は従来予想を上回り前年同期比で増収増益、各利益率も前年同期比で上昇。  
2Qの前四半期比での減収減益は、1Qへの出荷前倒しが要因。

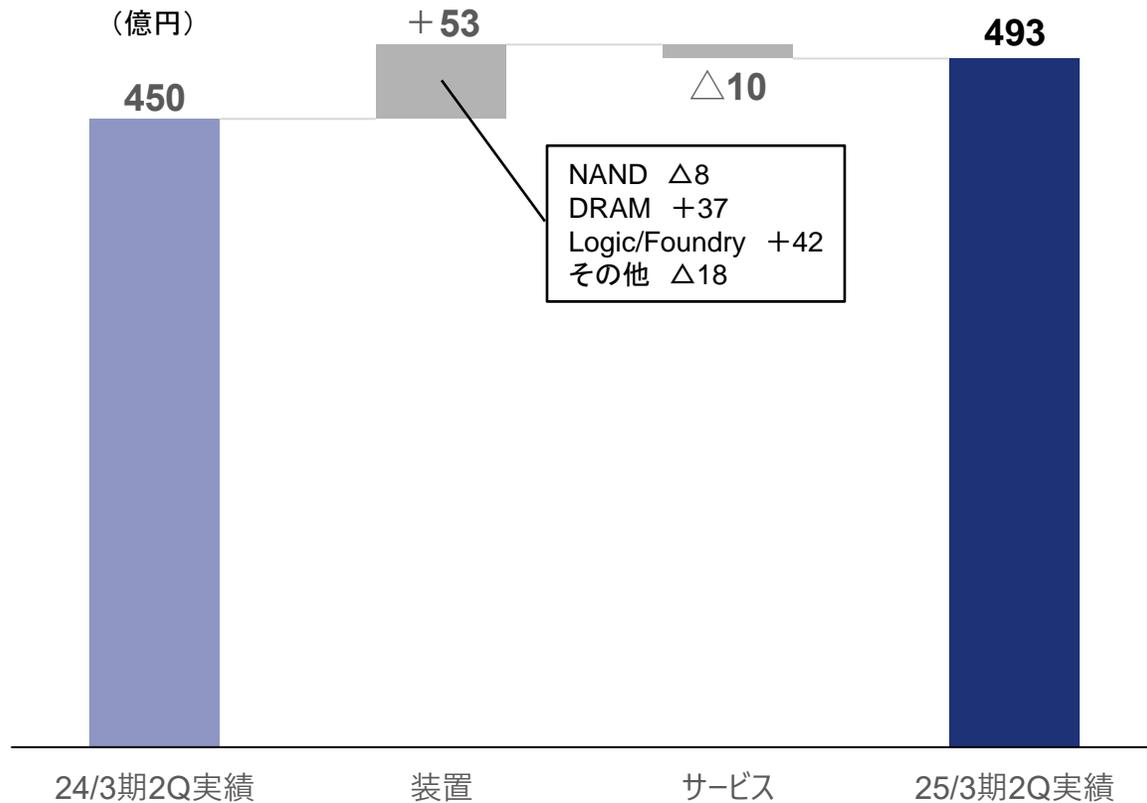
(億円)	24/3期			25/3期					
	1Q	2Q	2Q累計	1Q	2Q	前年同期比	前四半期比	2Q累計	前年同期比
売上収益	327	450	777	652	493	+9.6%	△24.4%	1,145	+47.4%
売上総利益	143	199	342	294	220	+10.7%	△25.0%	514	+50.3%
売上総利益率	43.6%	44.2%	44.0%	45.0%	44.6%	+0.4pts	△0.4pts	44.8%	+0.8pts
調整後営業利益	56	110	166	194	113	+2.4%	△41.7%	307	+84.3%
調整後営業利益率	17.2%	24.5%	21.4%	29.7%	22.9%	△1.6pts	△6.8pts	26.8%	+5.4pts
調整後当期(四半期)利益	38	73	111	143	73	△0.6%	△49.4%	216	+94.9%
調整後当期(四半期)利益率	11.6%	16.2%	14.3%	22.0%	14.7%	△1.5pts	△7.3pts	18.9%	+4.6pts
営業利益	40	94	134	179	96	+1.9%	△46.5%	274	+105.2%
営業利益率	12.2%	20.9%	17.2%	27.4%	19.4%	△1.5pts	△8.0pts	24.0%	+6.8pts
税引前当期(四半期)利益	37	91	129	177	102	+11.5%	△42.6%	279	+117.1%
税引前当期(四半期)利益率	11.4%	20.3%	16.6%	27.2%	20.7%	+0.4pts	△6.5pts	24.4%	+7.8pts
当期(四半期)利益	27	62	88	133	48	△22.8%	△64.3%	181	+104.8%
当期(四半期)利益率	8.1%	13.7%	11.3%	20.4%	9.6%	△4.1pts	△10.8pts	15.8%	+4.5pts
研究開発費	29	30	60	33	39	+29.7%	+17.1%	73	+22%
設備投資額	51	21	71	112	30	+45.6%	△73.1%	142	+99.1%
減価償却費	26	27	53	29	30	+13.3%	+3.9%	59	+11.9%

# 2025年3月期第2四半期実績 増減要因

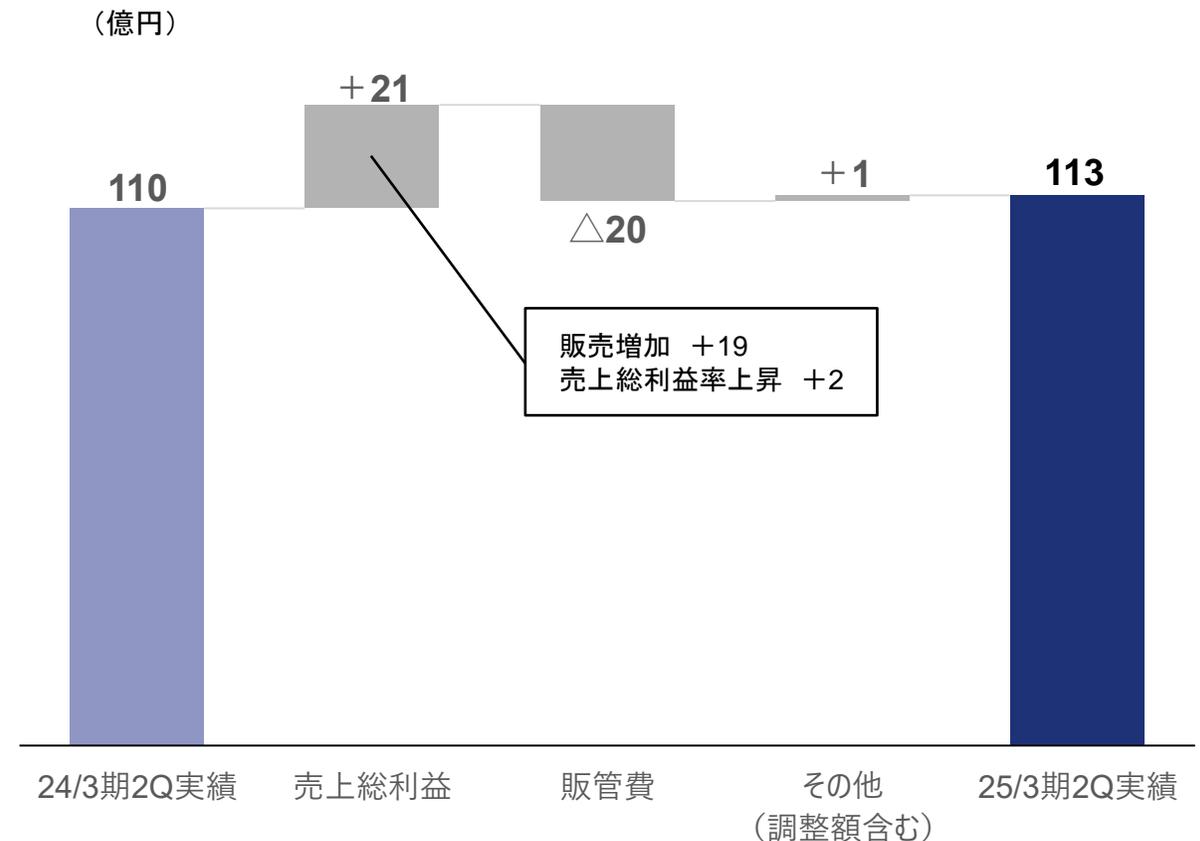
DRAM、Logic/Foundry向け装置販売の増加により、売上収益は前年同期比43億円増。

調整後営業利益は、販売増加と売上総利益率上昇による売上総利益の増加が販管費の増加を吸収し、前年同期比3億円増。

## 売上収益

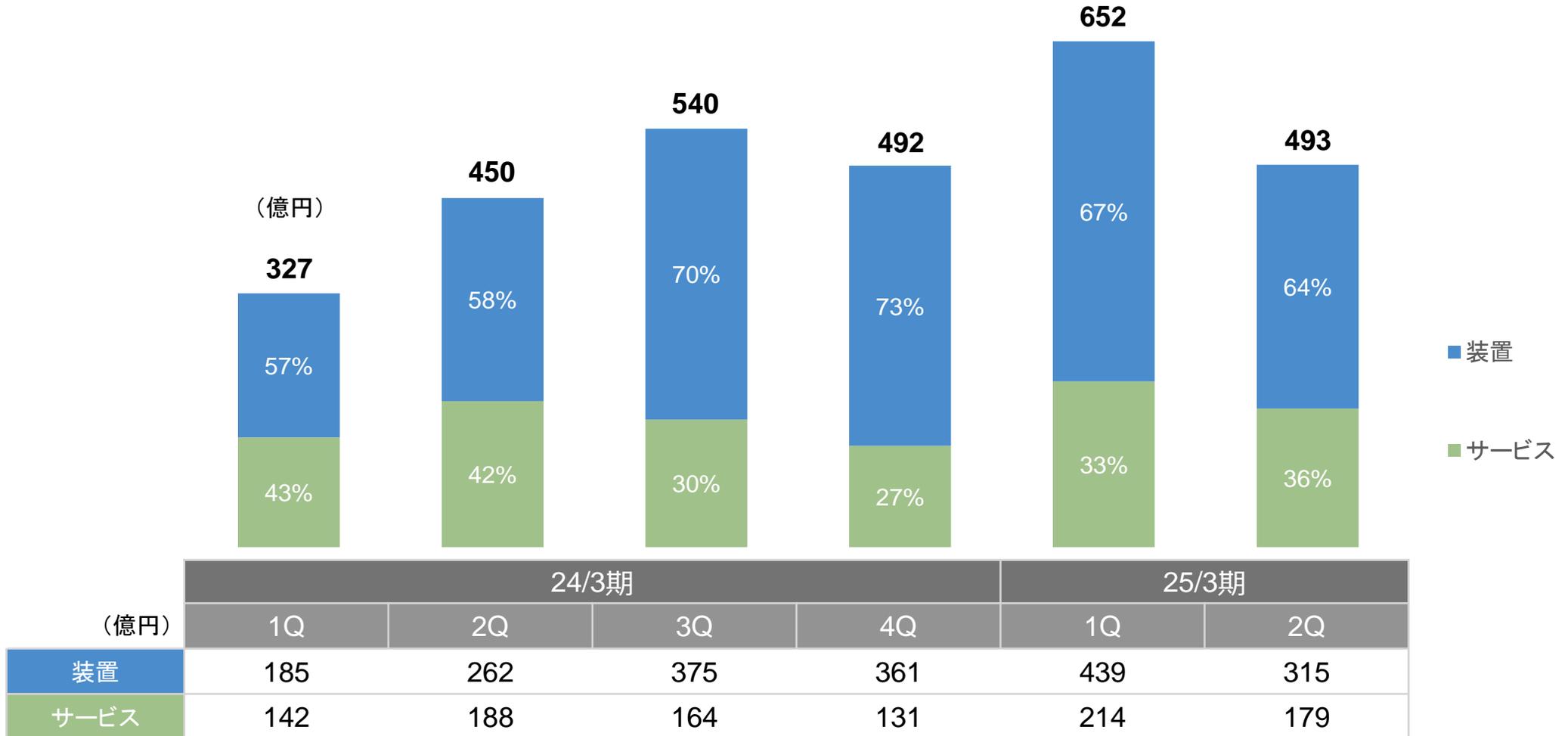


## 調整後営業利益



# 四半期別売上収益 ビジネス別

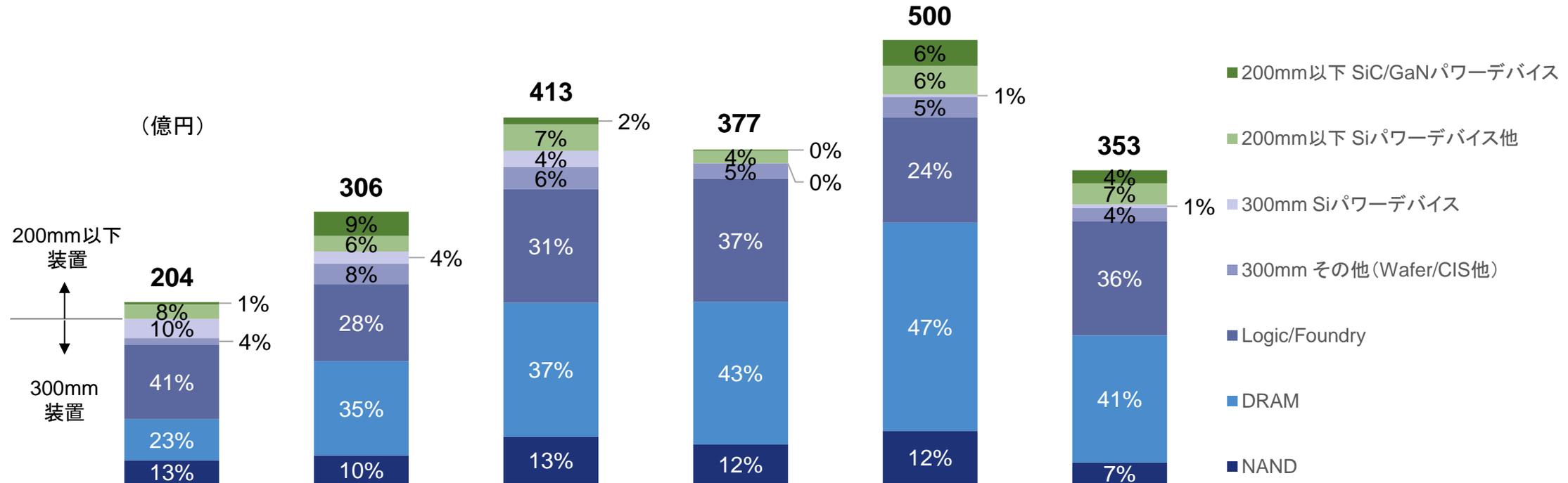
2Qは、装置売上の増加により、前年同期比で装置売上比率が拡大。  
 前四半期比では、2Qから1Qへの装置出荷前倒しが落ち着き、サービス売上比率が増加。



# 四半期別売上収益 アプリケーション別 (300mm装置+200mm以下装置)

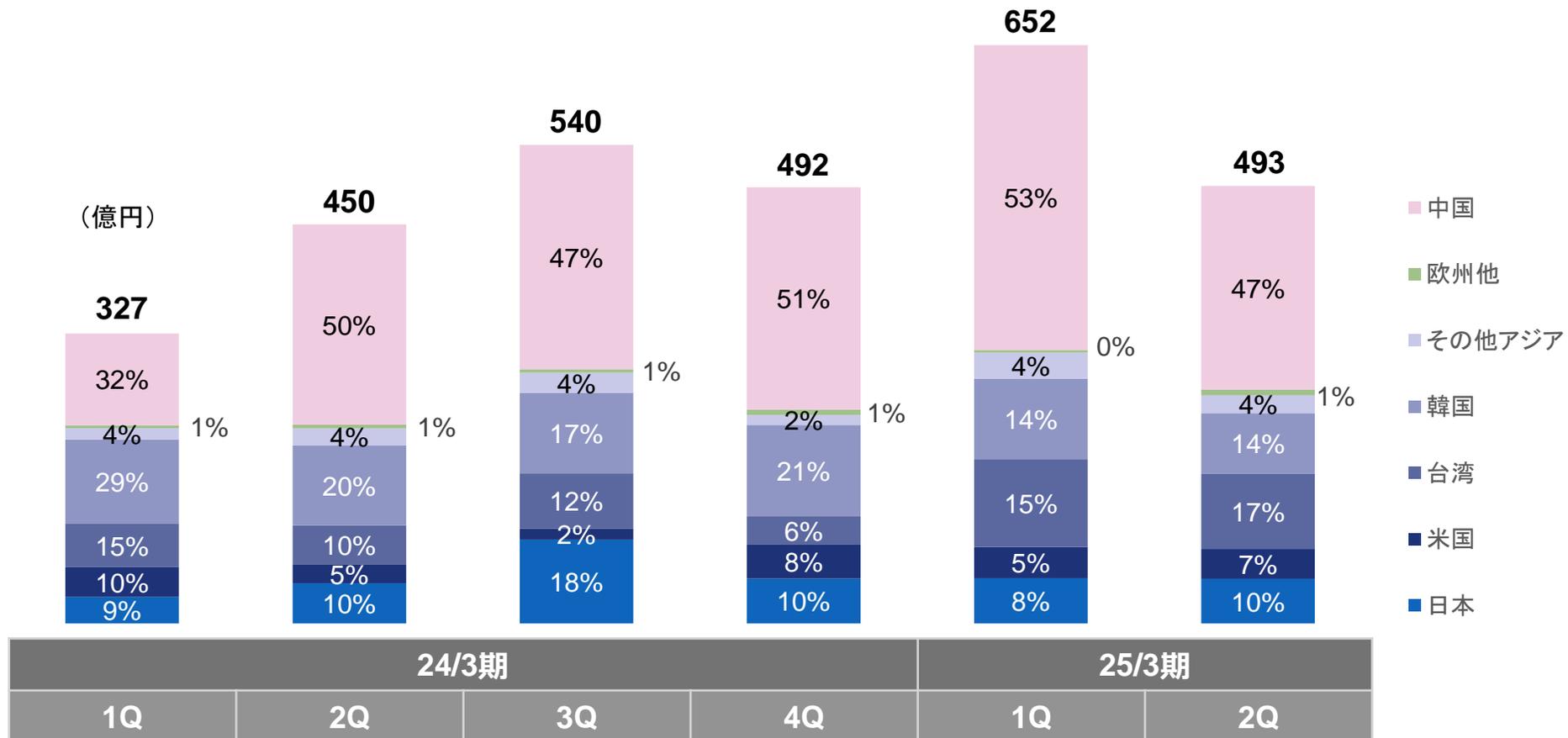
2Qは、前年同期比でDRAM、Logic/Foundryの売上比率が拡大。

前四半期比では、DRAM向け装置出荷の前倒しが落ち着き、Logic/Foundry売上比率が増加。



# 四半期別売上収益 地域別

2Qは、1Qに集中した中国向け装置の出荷が落ち着き、中国売上比率が低下。

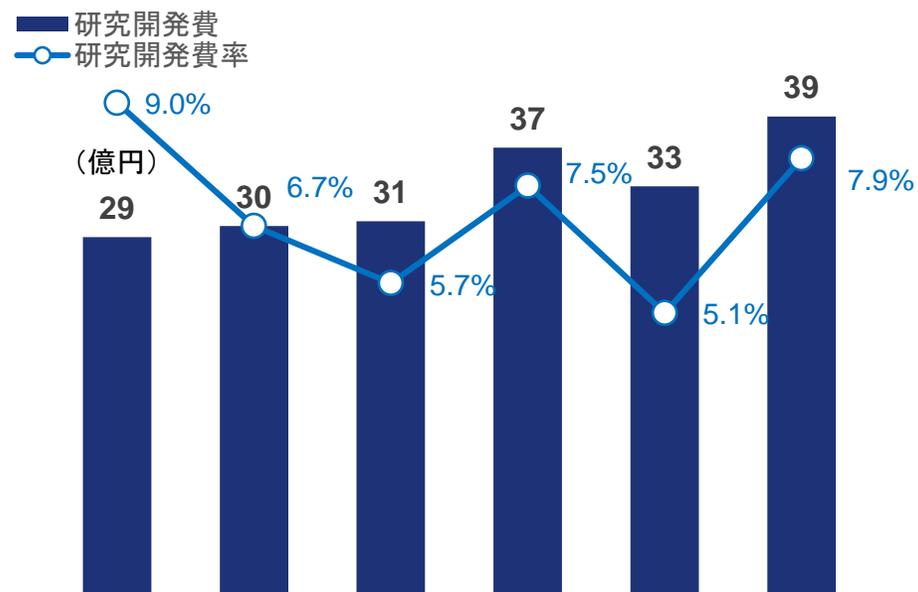


# 四半期別研究開発費／設備投資額／減価償却費

2Qの研究開発費は、次世代製品開発に向けて計画に沿って増加。

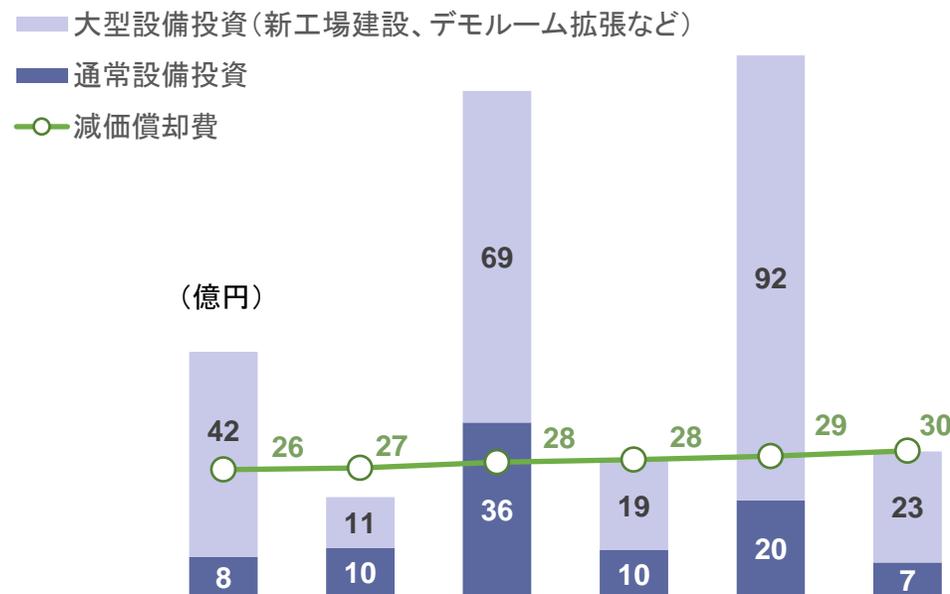
新工場建設による長期償却の大型設備投資が1Qで落ち着き、設備投資は平常化へ。

## 研究開発費



(億円)	24/3期				25/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
研究開発費	29	30	31	37	33	39
売上収益比	9.0%	6.7%	5.7%	7.5%	5.1%	7.9%

## 設備投資額／減価償却費



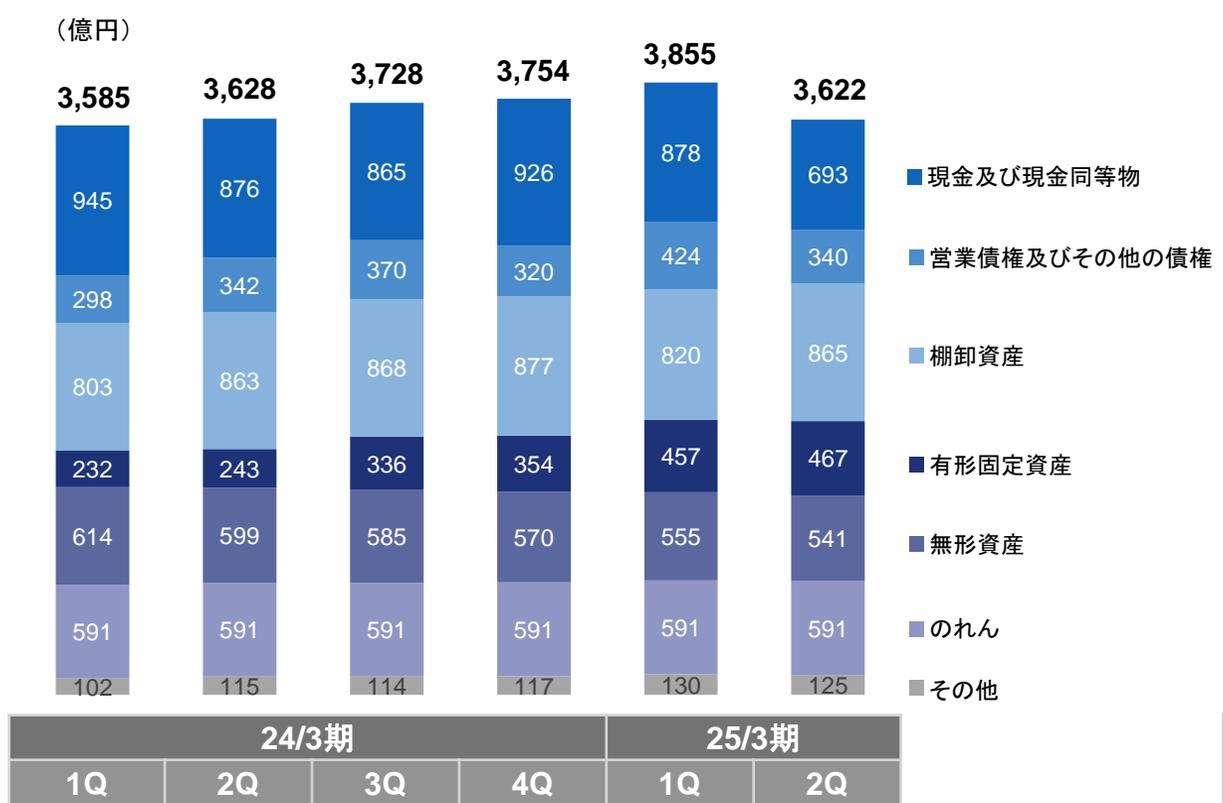
(億円)	24/3期				25/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
設備投資額計	51	21	105	28	112	30
売上収益比	15.5%	4.6%	19.4%	5.8%	17.2%	6.1%
減価償却費	26	27	28	28	29	30
売上収益比	8.1%	5.9%	5.2%	5.8%	4.5%	6.1%

# 四半期別貸借対照表

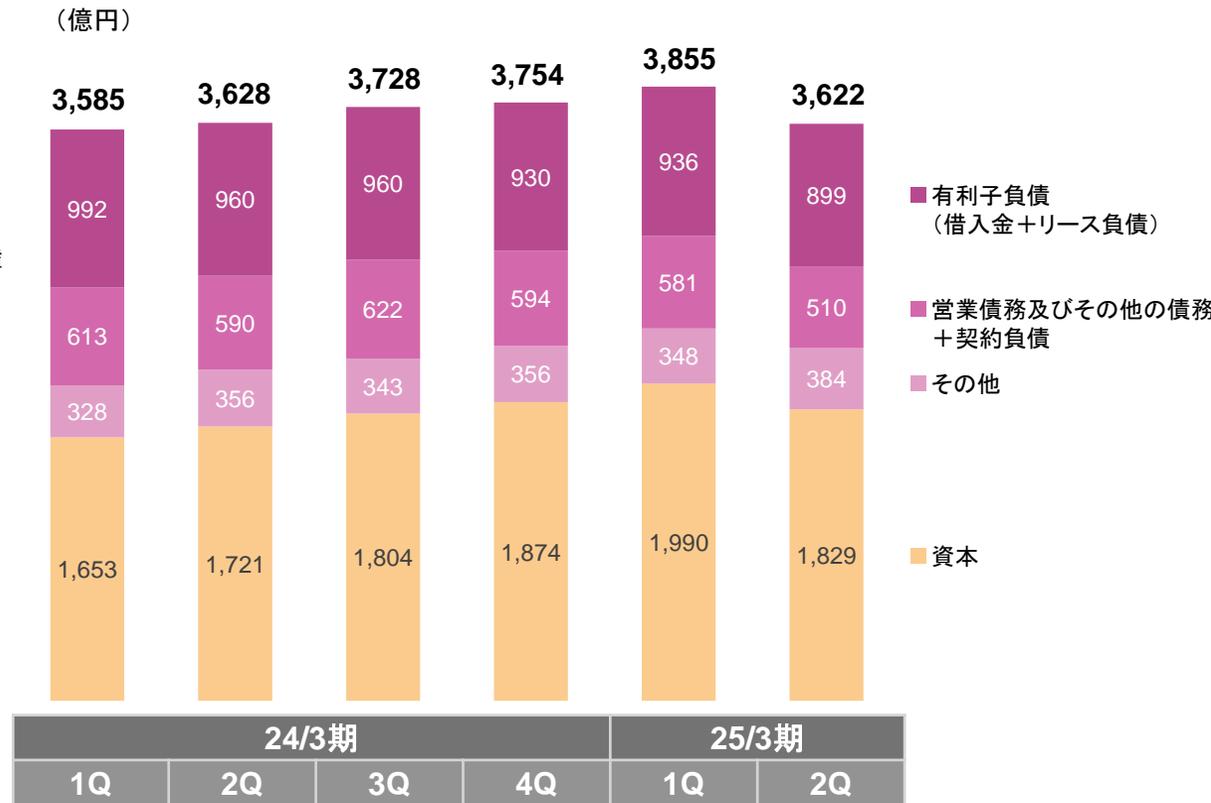
2Q末の資産合計は、新工場建設により有形固定資産が増加したものの、自己株式取得による現金及び現金同等物の減少により、前期末比で132億円減少。

資本合計は、利益剰余金の増加を自己株式取得の影響が上回り、前期末比で45億円減少。

## 資産

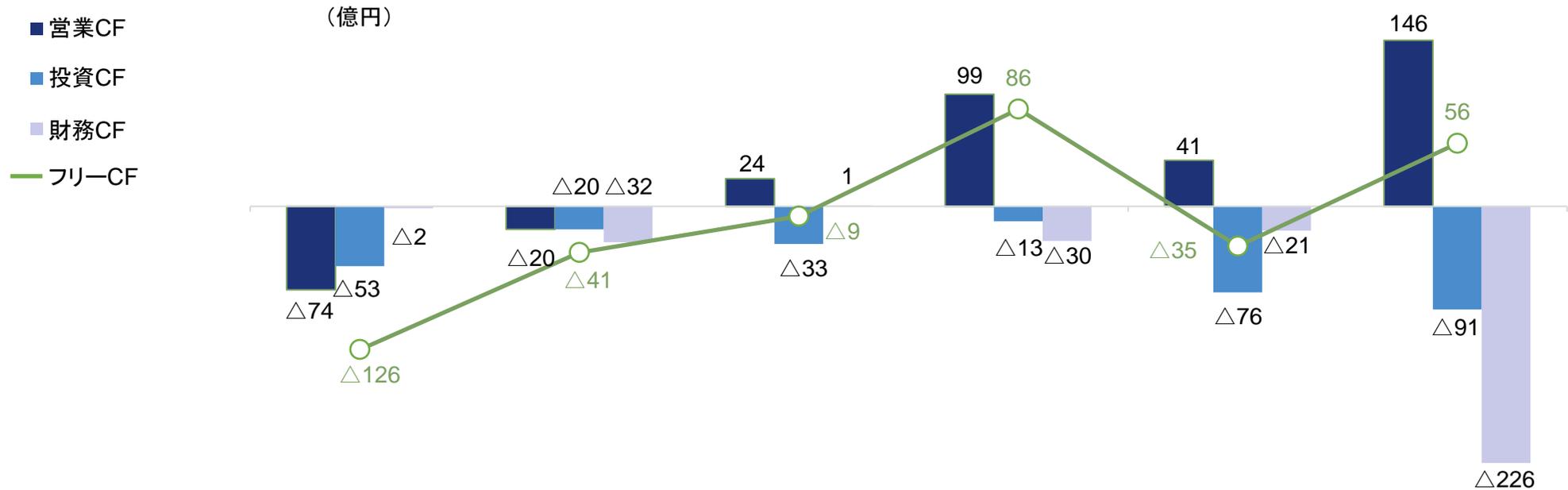


## 負債／資本



# 四半期別キャッシュ・フロー

1Q以来の売上収益回復に伴って営業CFの収入が回復し、2QのフリーCFは黒字化。  
財務CFは自己株式買取得により支出が増加。



(億円)	24/3期				25/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
営業CF	△74	△20	+24	+99	+41	+146
投資CF	△53	△20	△33	△13	△76	△91
財務CF	△2	△32	+1	△30	△21	△226
フリーCF	△126	△41	△9	+86	△35	+56
現金及び現金同等物残高	945	876	865	926	878	693

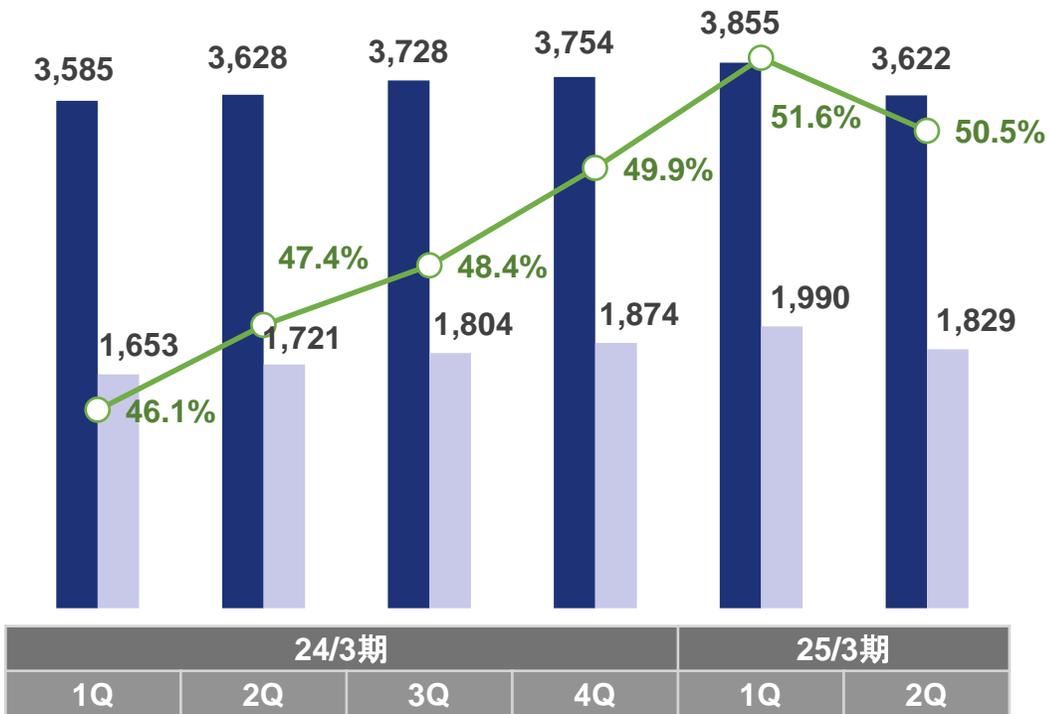
# 四半期別自己資本比率&現金及び現金同等物／有利子負債

2Q末の自己資本比率は、前期末比で0.6ポイント増加し、50.5%。

2Q末のネットデットは、自己株式取得の影響で増加し、206億円。

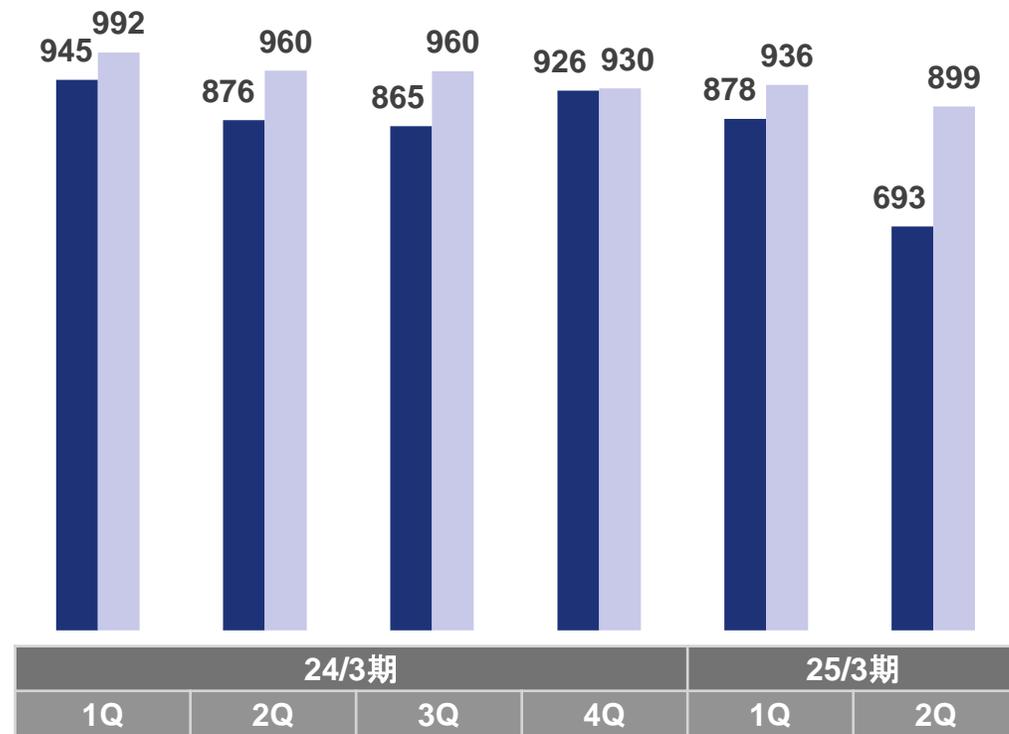
### 資産合計／資本合計／自己資本比率

(億円) ■ 資産合計 ■ 資本合計 ○ 自己資本比率



### 現金及び現金同等物／有利子負債

(億円) ■ 現金及び現金同等物 ■ 有利子負債





## 2025年3月期連結業績・配当予想

## 2025年3月期第2四半期連結決算概要

- 生成AIの普及等を背景にDRAMが好調。Logic/Foundryは先端ノードへの設備投資が増加基調。中国成熟ノード向けの活発な設備投資は落ち着き。
- 2Q累計は前年同期比で増収増益、各利益率も前年同期比で上昇。2Qの前四半期比での減収減益は、1Qへの出荷前倒しが要因。

## 2025年3月期連結業績・配当予想と今後の見通し

- 好調なDRAMに続いてLogic、NANDの回復が進むと想定。
- 当社3Q、4QはDRAM向けを中心に従来予想を上回る見通しとなったことから、通期業績・配当予想を修正。

# 2025年3月期業績・配当予想(変更あり)

売上収益は9%引き上げ前期比32%増、調整後営業利益は11%引き上げ前期比50%増を予想。  
年間配当金予想は4円引き上げ36円に修正(調整後当期利益ベースで配当性向21%)。

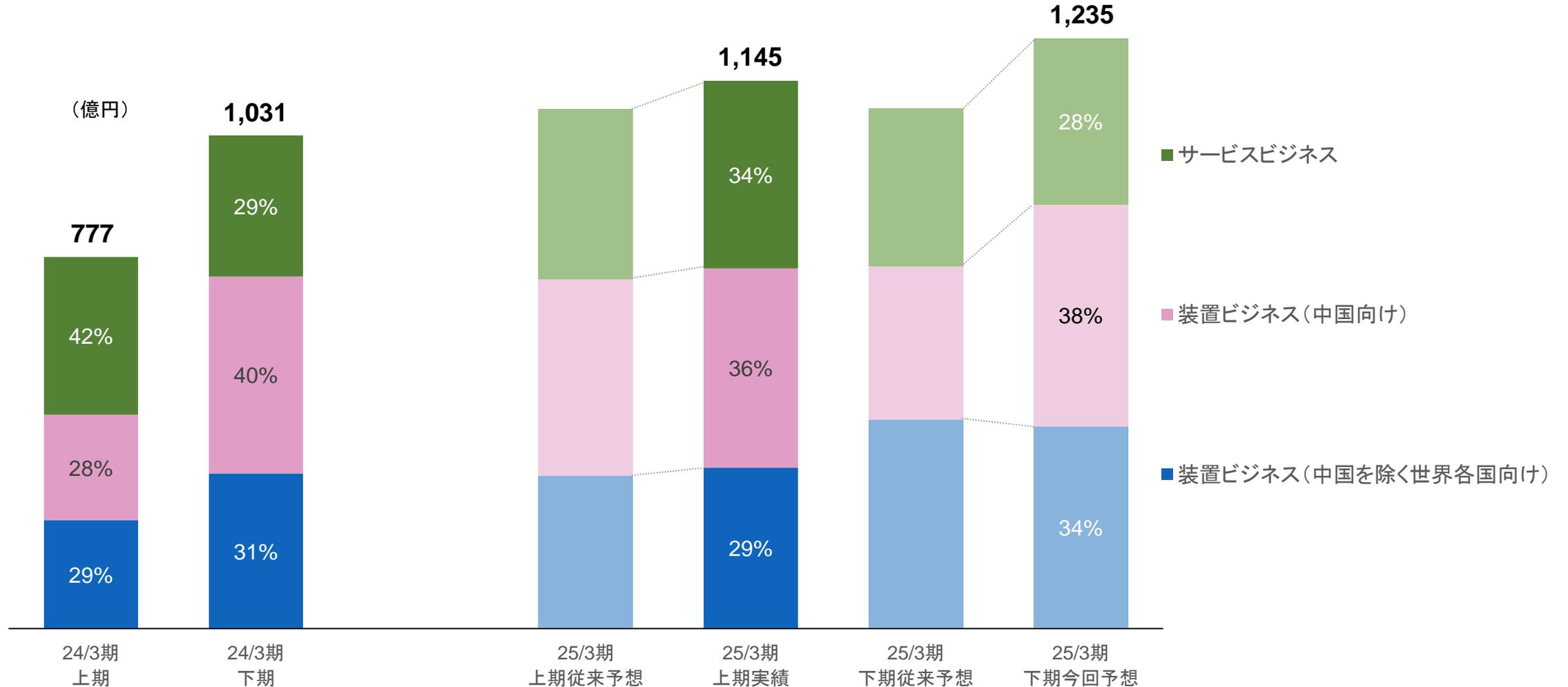
(億円)	24/3期			25/3期			
	通期実績	上期実績	下期今回予想	通期今回予想	前期比	従来予想比	通期従来予想
売上収益	1,808	1,145	1,235	2,380	+31.6%	+9.4%	2,175
売上総利益	750	514	496	1,009	+34.6%	+8.8%	927
売上総利益率	41.5%	44.8%	40.1%	42.4%	+0.9pts	△0.2pts	42.6%
調整後営業利益	378	307	260	566	+49.6%	+11.0%	510
調整後営業利益率	20.9%	26.8%	21.0%	23.8%	+2.9pts	+0.4pts	23.4%
調整後当期(四半期)利益	273	216	181	396	+45.1%	+11.2%	356
調整後当期(四半期)利益率	15.1%	18.9%	14.6%	16.7%	+1.6pts	+0.3pts	16.4%
営業利益	307	274	228	502	+63.3%	+12.1%	448
営業利益率	17.0%	24.0%	18.5%	21.1%	+4.1pts	+0.5pts	20.6%
税引前当期(四半期)利益	298	279	222	501	+68.4%	+13.9%	440
税引前当期(四半期)利益率	16.5%	24.4%	18.0%	21.1%	+4.6pts	+0.9pts	20.2%
当期(四半期)利益	224	181	153	333	+48.8%	+14.8%	290
当期(四半期)利益率	12.4%	15.8%	12.4%	14.0%	+1.6pts	+0.7pts	13.3%
1株当たり配当金(円)	11 <sup>*1</sup>	18	18	36	—	+12.5%	32
配当性向(調整後当期利益ベース)	9.3%	19.2%	23.1%	21.0%	—	+0.1pts	20.9%

\*1 24/3期の1株当たり配当金につきましては、上場時期が下半期であったことを踏まえて半期分の金額としました。

# 2025年3月期業績予想 上期・下期別売上収益(変更あり)

上期は、DRAM向け装置販売、部品販売が上振れ。

下期は、DRAM、Logic/Foundry向け装置販売、レガシー装置販売が従来予想を上回る見通し。

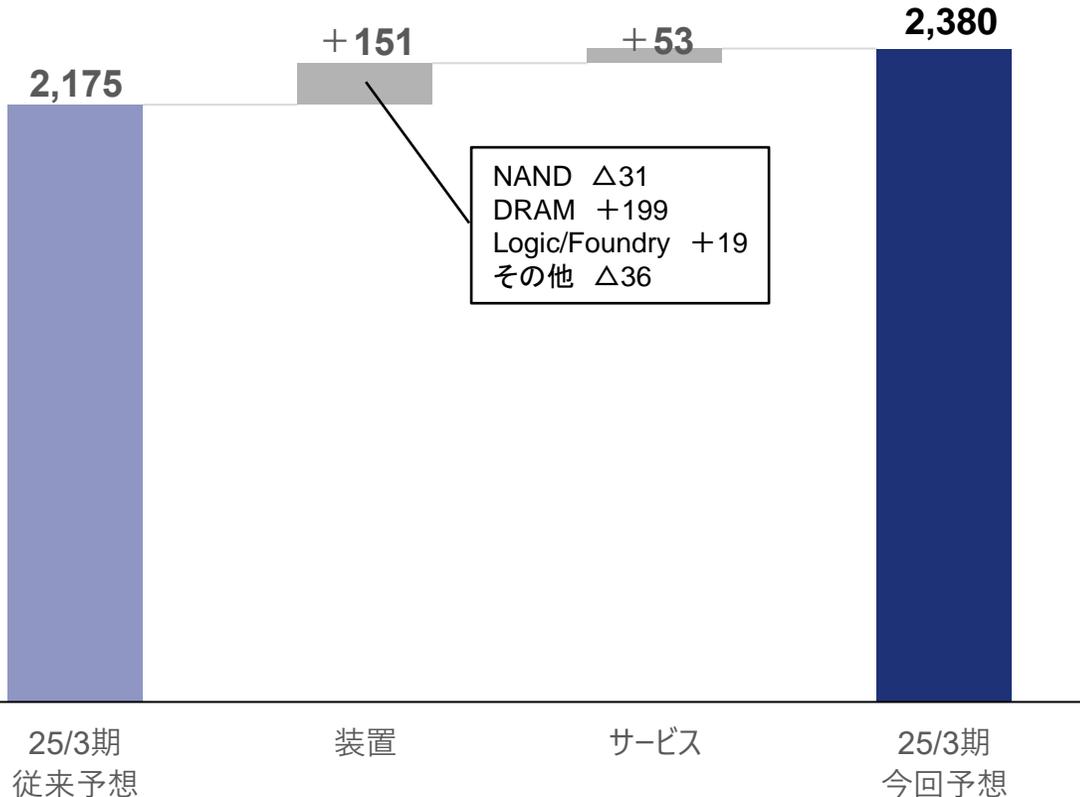


# 2025年3月期業績予想 増減要因(変更あり)

DRAM、Logic/Foundry向け装置販売、部品、レガシー装置販売の増加により、調整後営業利益の増加を見込む。売上総利益率は案件構成の変化と一時費用で微減、販管費は積極投資で増加。

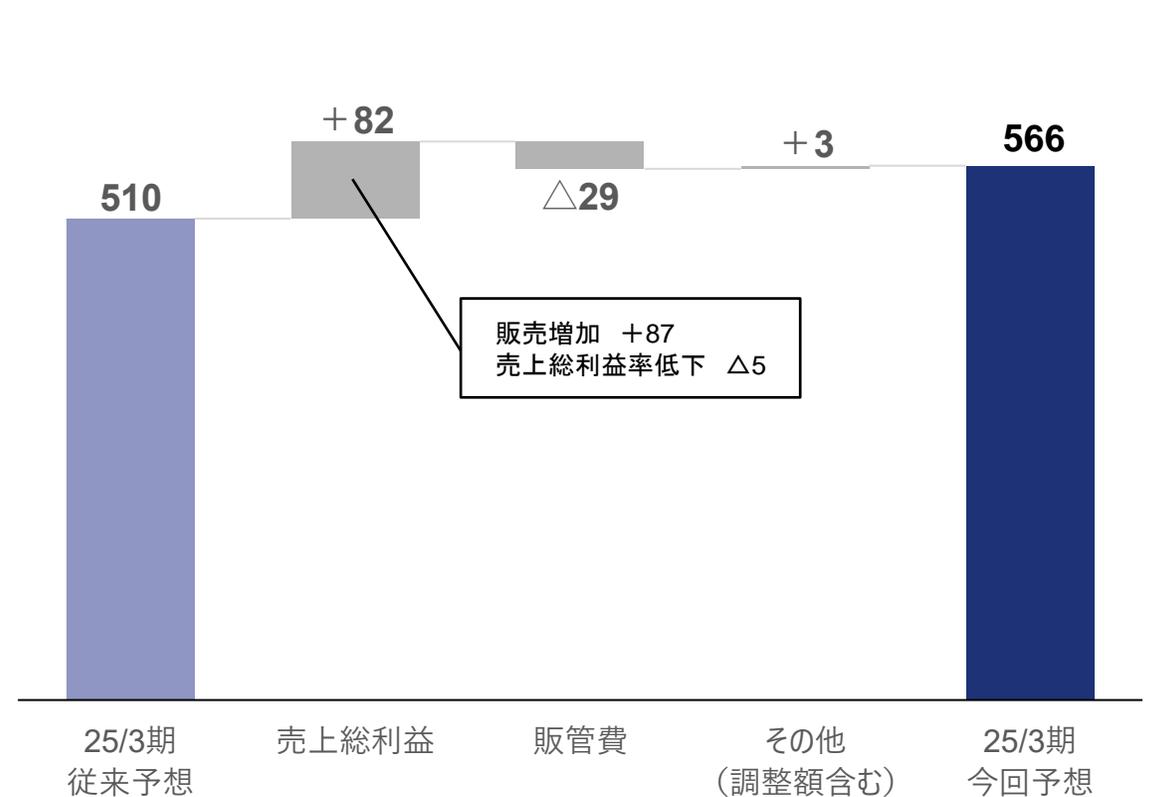
## 売上収益

(億円)



## 調整後営業利益

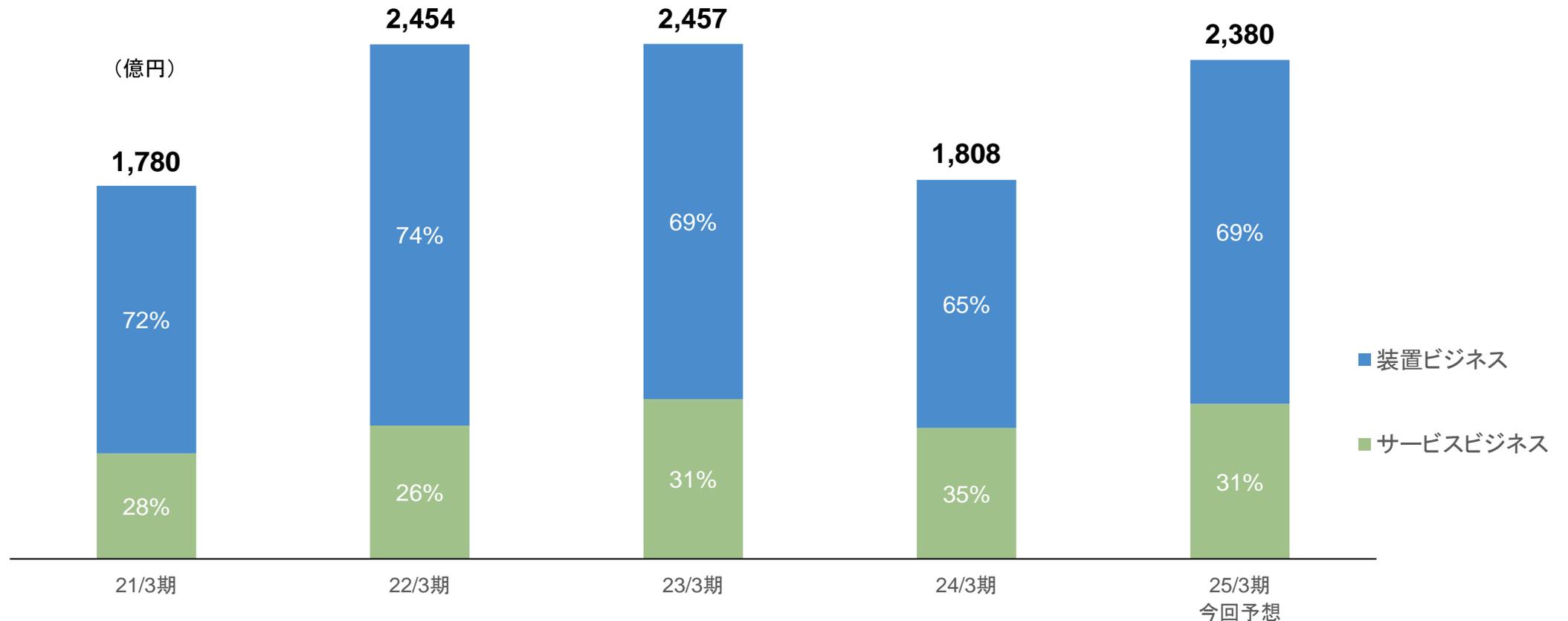
(億円)



# 2025年3月期業績予想 ビジネス別売上収益(変更あり)

装置の売上回復ペースが速まり、ビジネス別売上構成比はほぼ平常化。

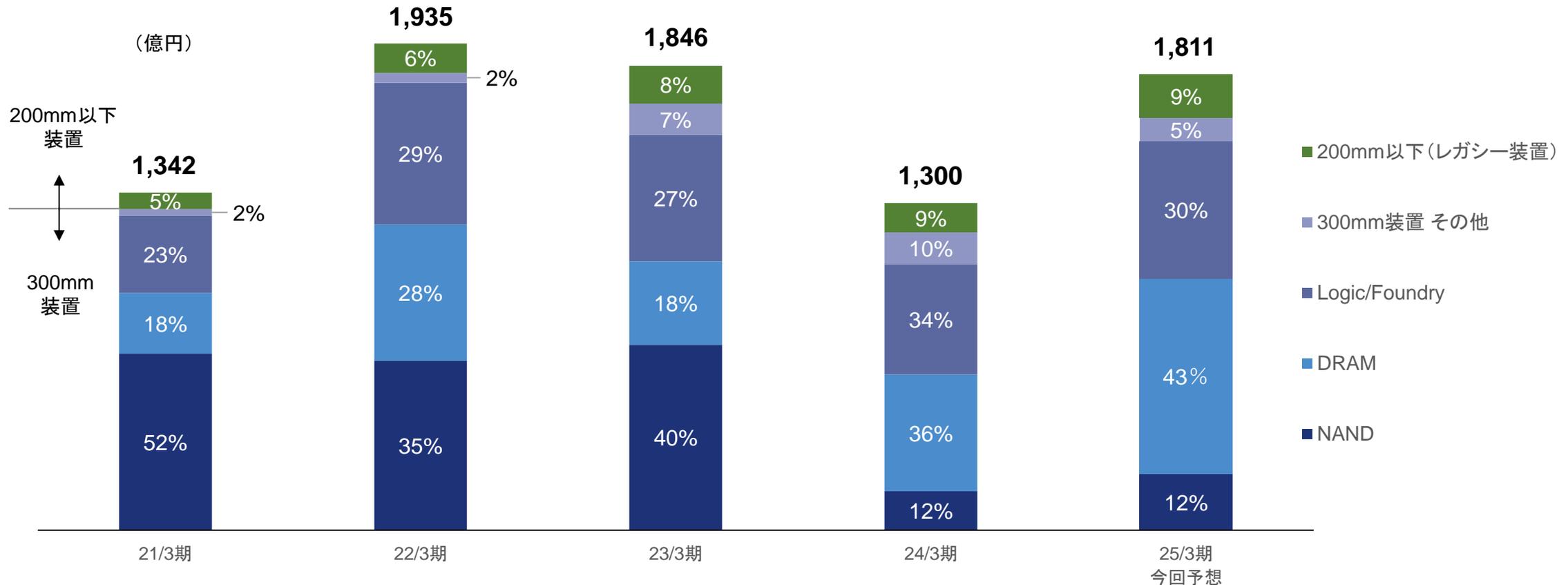
装置売上は10%引き上げ前期比39%増の1,640億円、サービス売上は8%引き上げ前期比18%増の740億円を予想。



# 2025年3月期業績予想 アプリケーション別売上収益\*1(変更あり)

グローバルに好調なDRAMの売上比率が高まる見通し。

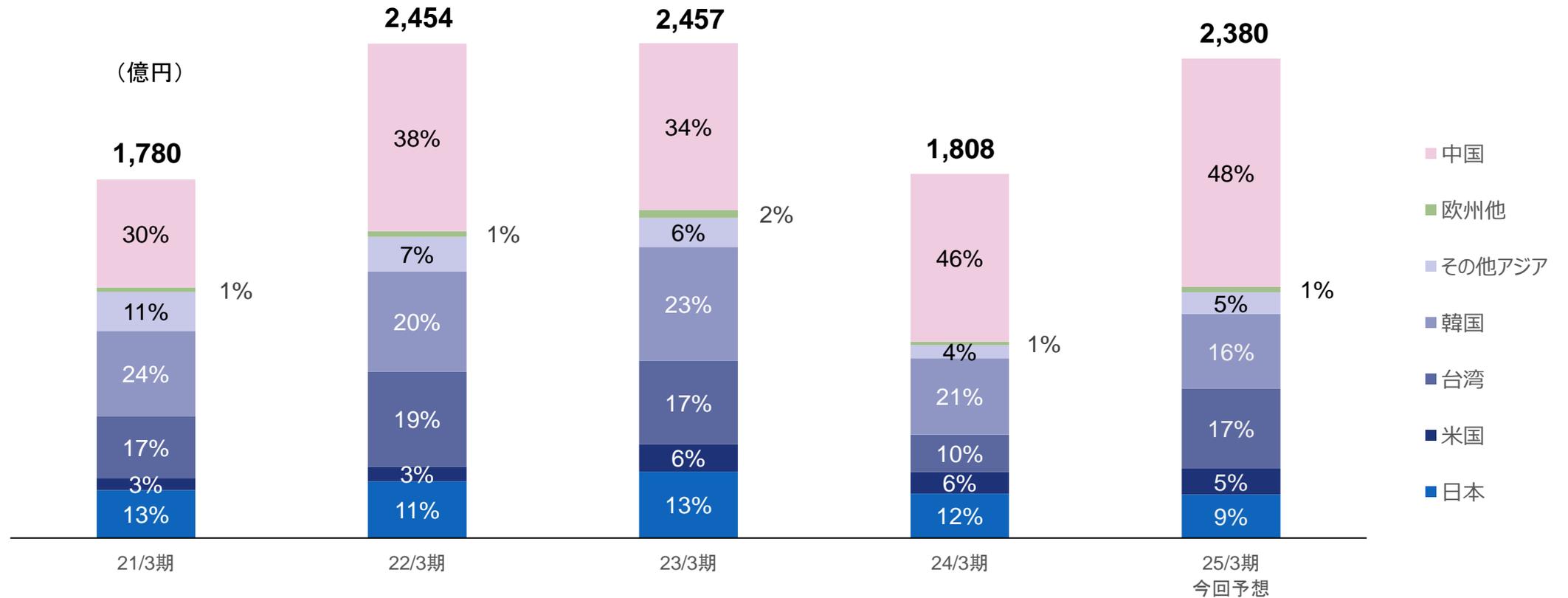
Logic/Foundry、NANDの売上比率は相対的に低下するものの、それぞれの装置販売は前期比で増加する見通し。



\*1 300mm装置+200mm以下装置(レガシー装置)

# 2025年3月期業績予想 地域別売上収益(変更あり)

25/3期は中国売上比率が増加する見通しながら、世界各国での先端デバイス向け投資回復に伴い、26/3期の中国売上比率は従来水準に落ち着く見通し。





## 今後の見通し

# 事業環境の見通し

DRAMに続いてLogic、NANDの回復が進むと想定。中長期的に大きな成長を遂げるとの見方に変更なし。

## 半導体デバイス市場

- 半導体デバイス市場では、生成AI関連の需要が拡大しており、今後はそれ以外の先端デバイスの需要が増加する。
- 中国での成熟ノード向けの活発な設備投資は、落ち着きが見られるものの、今後数年は相応の規模が持続する。
- 中長期的には、電子機器の需要拡大、データセンターの拡充、環境負荷低減への投資(GX)等により、大きな成長が期待される。

## 半導体製造装置市場

- DRAM向け装置販売の増加に続いて、25/3期後半から先端ノードLogic、NAND向け装置販売が回復し始めると想定。
- 中国市場ではDRAM向け装置需要が予想以上に増加。成熟ノードLogic向けは落ち着きが見られるものの成膜領域は比較的安定。
- WFE市場のCY24の規模はCY23比で微増ながら、今後数年で1,200億ドル程度まで成長すると想定。

### 半導体デバイス／半導体製造装置の世界市場規模(単位:USD Bn)

	2010年	2022年	2023年	2028年(予想)
半導体デバイスの世界市場規模	296.7	613.9	559.1	926.7
半導体製造装置の世界市場規模	30.4	98.1	98.5	142.7

出所:TechInsights Inc. Semiconductor Forecast (September 2024)

出所:TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (September 2024)

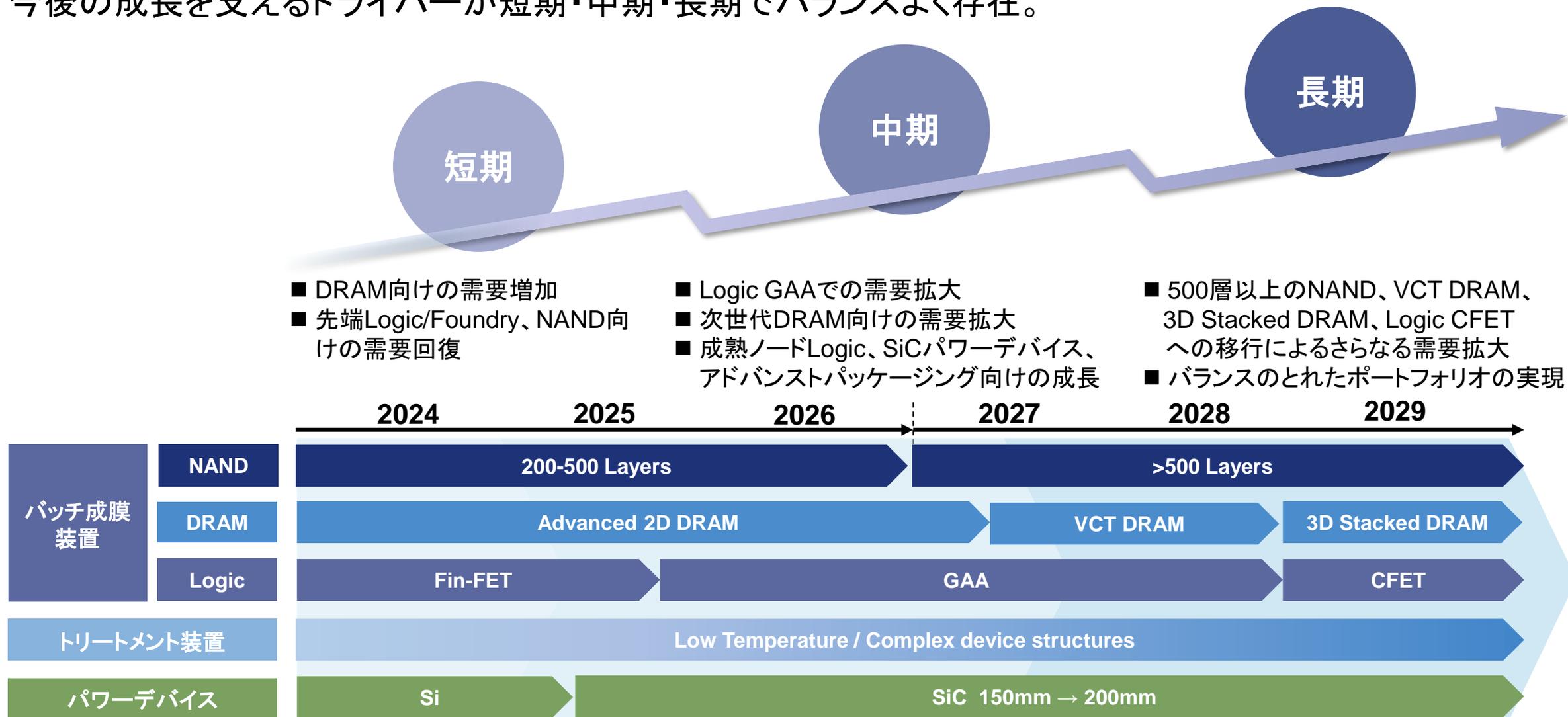
# アプリケーション別の取り組み

3D NANDで先行した技術的優位性をDRAMやLogicに展開し、中期ではLogic/Foundry他:DRAM:NAND=50:25:25のバランスをめざす。パワーデバイス、アドバンストパッケージング向けも新たな成長をめざす。

	事業環境	当社の取り組み
DRAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>・足元では生成AIの普及によるHBM需要拡大により、<b>先端ノード向け装置需要</b>が増加。</li> <li>・25/3期下期から世界で<b>先端ノード向け装置需要</b>が本格回復。</li> <li>・<b>中国向け装置需要</b>は引き続き旺盛。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・先端ノード向け<b>高難易度成膜、トリートメント</b>で<b>新規POR</b>獲得。</li> <li>・デバイス進化でTAM拡大、さらなる<b>新規POR</b>獲得をめざす。</li> <li>・VCT DRAM、3D Stacked DRAMでのデバイス構造複雑化に伴い、3D NANDと同様に<b>シェア拡大</b>をめざす。</li> </ul>
Logic/Foundry	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DRAM向けに続いて、25/3期下期から<b>先端ノード向け装置需要</b>が回復。</li> <li>・<b>中国成熟ノード向け装置需要</b>は落ち着くものの、相応の規模が持続。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・GAA向け売上は順調に増加。中長期で売上拡大をめざす。</li> <li>・欧米の成熟ノード向け装置販売の拡大に注力。</li> <li>・高難易度成膜でアドバンストパッケージング向けの<b>新たな売上成長</b>をめざす。</li> </ul>
NAND	<ul style="list-style-type: none"> <li>・足元では<b>開発用途装置の需要</b>が増加。</li> <li>・25/3期4Qから世界で<b>先端ノード向け装置需要</b>が回復し始め、26/3期に本格回復。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラージバッチ/ミニバッチALD対応成膜装置、枚葉トリートメント装置のラインアップにより、3D NANDの成膜プロセスで<b>圧倒的シェア</b>を持続。</li> <li>・<b>市況回復とデバイスの多層化</b>が進むにつれて売上回復・拡大。</li> </ul>
SiCパワーデバイス (サービスビジネス)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>高温活性化アニール装置</b>のニーズ拡大。</li> <li>・デバイスのウェーハサイズが<b>150mmから200mm</b>に移行するとともに需要拡大が期待。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・25/3期は<b>高温活性化アニール新製品投入</b>を進めつつ、<b>既存製品の売上伸長</b>。</li> <li>・ALD-SiO<sub>2</sub>における<b>新たなソリューション</b>を開発。</li> </ul>

# まとめ

今後の成長を支えるドライバーが短期・中期・長期でバランスよく存在。



# 自己株式取得の結果と自己株式保有方針について

株式売出しに伴う需給悪化を緩和するため、180億円の自己株式取得を完了。  
取得済みの自己株式は報酬制度等に活用、今後取得する自己株式は消却を原則。

## 自己株式取得について

- 取得期間 2024年7月30日～2024年9月10日
- 取得した株式の総数 5,058,400 株
- 株式の取得価額の総額 17,999,748,791 円
- 取得の方法 株式会社東京証券取引所における市場買付

(参考)2024年9月30日時点

発行済株式総数	自己株式数
236,049,790株	5,058,400株

## 自己株式保有方針について

- 従来の方針  
自己株式については、保有する株式数の上限を設定し、上限を超過した株式は消却することを基本。
- 今後の方針  
取得済みの自己株式(5,058千株)については、株式報酬制度等に活用するため、**消却は行わず保有**する予定。  
今後取得する自己株式については、**消却を原則とする**。ただし、株式報酬制度等により活用が見込まれる発行済株式総数の1%を上限に保有する。



# Appendix

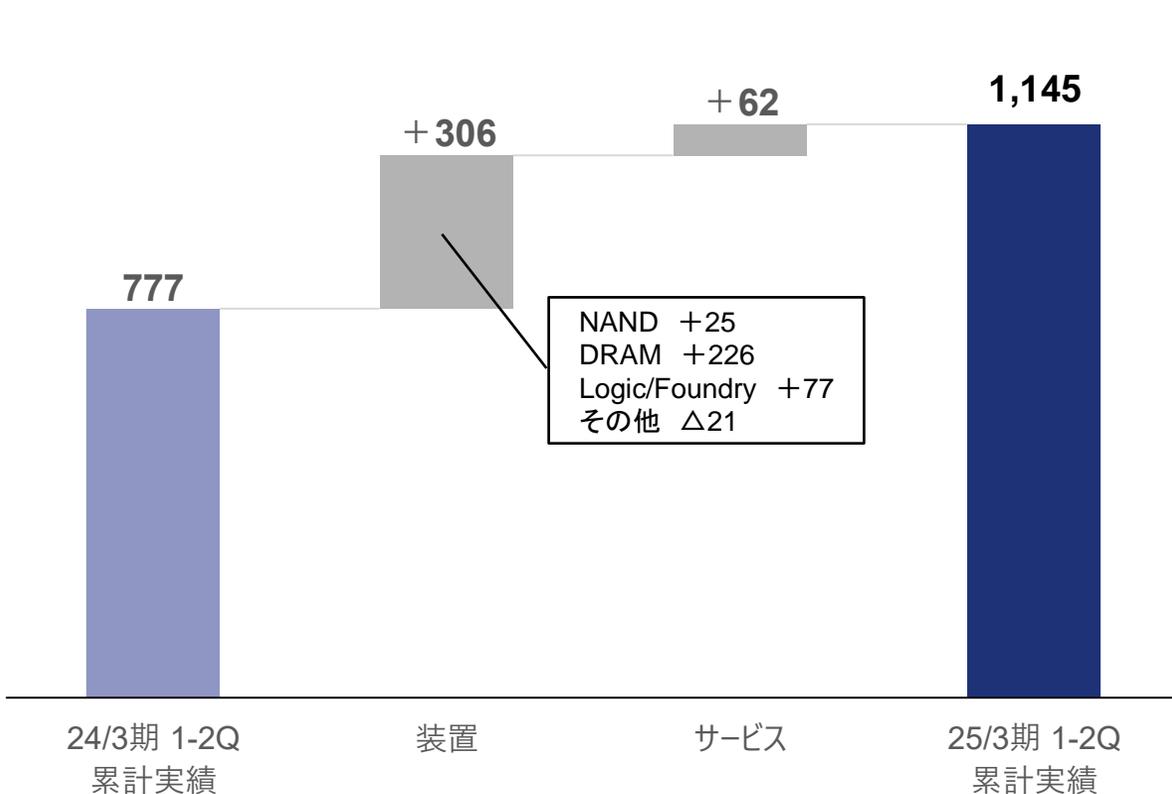
# 2025年3月期第2四半期(累計)実績 増減要因

売上収益は、すべてのアプリケーション向けで装置販売が回復し、前年同期比で増収。

調整後営業利益は、販売増加と売上総利益率の上昇により、前年同期比で増益。

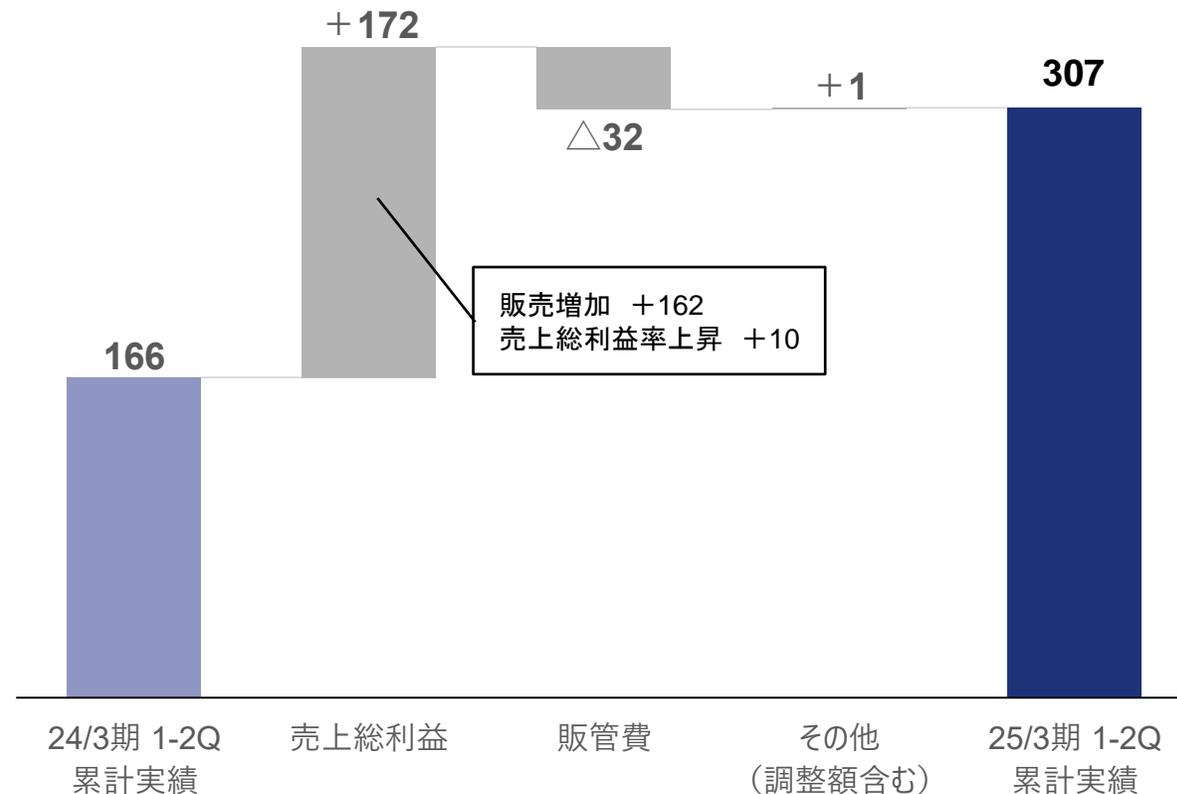
## 売上収益

(億円)



## 調整後営業利益

(億円)



# 損益計算書及び研究開発費、設備投資額、減価償却費

(百万円)	24/3期					25/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q
売上収益	32,710	44,995	53,956	49,177	180,838	65,224	49,324
売上総利益	14,275	19,890	21,741	19,059	74,965	29,354	22,012
売上総利益率	43.6%	44.2%	40.3%	38.8%	41.5%	45.0%	44.6%
調整後営業利益	5,614	11,035	12,400	8,790	37,839	19,382	11,299
調整後営業利益率	17.2%	24.5%	23.0%	17.9%	20.9%	29.7%	22.9%
調整後当期(四半期)利益	3,782	7,304	9,101	7,109	27,296	14,345	7,262
調整後当期(四半期)利益率	11.6%	16.2%	16.9%	14.5%	15.1%	22.0%	14.7%
営業利益	3,990	9,383	10,689	6,683	30,745	17,878	9,562
営業利益率	12.2%	20.9%	19.8%	13.6%	17.0%	27.4%	19.4%
税引前当期(四半期)利益	3,727	9,145	10,742	6,143	29,757	17,747	10,195
税引前当期(四半期)利益率	11.4%	20.3%	19.9%	12.5%	16.5%	27.2%	20.7%
当期(四半期)利益	2,655	6,158	7,914	5,647	22,374	13,302	4,751
当期(四半期)利益率	8.1%	13.7%	14.7%	11.5%	12.4%	20.4%	9.6%
研究開発費	2,932	3,023	3,062	3,666	12,683	3,348	3,920
設備投資額	5,077	2,071	10,478	2,828	20,454	11,215	3,015
減価償却費	2,637	2,671	2,792	2,845	10,945	2,914	3,027

# 調整後利益等の計算における調整項目

(百万円)	24/3期					25/3期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q
<b>営業利益</b>	<b>3,990</b>	<b>9,383</b>	<b>10,689</b>	<b>6,683</b>	<b>30,745</b>	<b>17,878</b>	<b>9,562</b>
－その他の収益	△30	△110	△285	△254	△679	△92	△187
＋その他の費用	45	33	19	390	487	27	78
(調整額)							
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,592	1,593	1,592	6,369	1,479	1,477
＋スタンドアローン関連費用	1	10	203	9	223	12	298
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	16	127	181	370	694	78	71
調整額 計	1,609	1,729	1,977	1,971	7,286	1,569	1,846
<b>調整後営業利益</b>	<b>5,614</b>	<b>11,035</b>	<b>12,400</b>	<b>8,790</b>	<b>37,839</b>	<b>19,382</b>	<b>11,299</b>
<b>当期(四半期)利益</b>	<b>2,655</b>	<b>6,158</b>	<b>7,914</b>	<b>5,647</b>	<b>22,374</b>	<b>13,302</b>	<b>4,751</b>
－その他の収益	△30	△110	△285	△254	△679	△92	△187
＋その他の費用	45	33	19	390	487	27	78
(調整額)							
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,592	1,593	1,592	6,369	1,479	1,477
＋スタンドアローン関連費用	1	10	203	9	223	12	298
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	16	127	181	370	694	78	71
－調整項目に対する税金調整額	△497	△506	△524	△645	△2,172	△461	△531
＋一時的な税金費用の調整額	-	-	-	-	-	-	1,305
<b>調整後当期(四半期)利益</b>	<b>3,782</b>	<b>7,304</b>	<b>9,101</b>	<b>7,109</b>	<b>27,296</b>	<b>14,345</b>	<b>7,262</b>

# 貸借対照表及び主要財務指標

(百万円)		24/3期			25/3期		
		4Q末	1Q末	2Q末	4Q末	1Q末	2Q末
資産	流動資産	現金及び現金同等物	92,619	87,775	69,333		
		営業債権及びその他の債権	31,994	42,444	33,979		
		棚卸資産	87,682	82,028	86,542		
		その他	2,619	2,787	1,923		
		流動資産合計	214,914	215,034	191,777		
	非流動資産	有形固定資産	35,382	45,696	46,714		
		のれん	59,065	59,065	59,065		
		無形資産	56,995	55,480	54,073		
		その他	9,077	10,179	10,609		
		非流動資産合計	160,519	170,420	170,461		
資産合計		375,433	385,454	362,238			

(百万円)		24/3期			25/3期		
		4Q末	1Q末	2Q末	4Q末	1Q末	2Q末
負債	流動負債	借入金＋リース負債	8,019	8,055	8,843		
		営業債務及びその他の債務	36,667	38,657	31,275		
		契約負債	22,719	19,394	19,734		
		その他	20,138	19,554	22,510		
		流動負債合計	87,543	85,660	82,362		
	非流動負債	借入金＋リース負債	84,999	85,555	81,059		
		その他	15,503	15,199	15,900		
		非流動負債合計	100,502	100,754	96,959		
	負債合計		188,045	186,414	179,321		
	資本合計		187,388	199,040	182,917		
負債及び資本合計		375,433	385,454	362,238			

	24/3期			25/3期		
	4Q末	1Q末	2Q末	4Q末	1Q末	2Q末
自己資本比率	49.9%	51.6%	50.5%			
D/Eレシオ	0.5	0.5	0.5			
ネット・キャッシュ(百万円)	△ 399	△ 5,835	△ 20,569			

# キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	24/3期					25/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	2Q累計
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,365	△ 2,030	2,443	9,894	2,942	4,073	14,649	18,722
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,278	△ 2,037	△ 3,321	△ 1,314	△ 11,950	△ 7,582	△ 9,090	△ 16,672
フリー・キャッシュ・フロー	△ 12,643	△ 4,067	△ 878	8,580	△ 9,008	△ 3,509	5,559	2,050
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 167	△ 3,171	70	△ 3,044	△ 6,312	△ 2,143	△ 22,628	△ 24,771
現金及び現金同等物の期首残高	106,053	94,493	87,550	86,498	106,053	92,619	87,775	92,619
現金及び現金同等物の四半期末残高	94,493	87,550	86,498	92,619	92,619	87,775	69,333	69,333

# 2025年3月期第2四半期(累計)の主な活動報告 経営・事業活動

- 新工場「砺波事業所」の竣工式を開催。(24/9)
- 第85回 応用物理学会 秋季学術講演会、ADMETA Plus 2024に協賛。(24/9)
- SEMICON® TAIWAN 2024に出展。(24/9)
- 2024 International Conference on Solid State Devices and Materials にプラチナスポンサーとして協賛。(24/8)
- 自己株式(5,058,400株)の取得完了。(24/9)
- 当社普通株式(60,381,700株)の売出し完了。(24/7)
- SEMICON® WEST 2024に出展。(24/7)
- FTSE Russell社が運用する「FTSE Global Equity Index Series」構成銘柄に当社が採用。(24/6)
- TechInsightsの顧客満足度調査で「10 BEST Suppliers」と「THE BEST Suppliers」を受賞。(24/5)
- PSMC(Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation)の新工場開所式で感謝状を受領。(24/5)



10月から稼働した砺波事業所の竣工式を開催



「SEMICON® WEST 2024」「SEMICON® TAIWAN 2024」に出展

# 2025年3月期第2四半期(累計)の主な活動報告 ESGの取り組み

- 富山県より「とやま女性活躍企業」に認定。(24/9)
- 富山市八尾町で開催される「おわら風の盆」に協賛。(24/9)
- 献血運動推進協力団体厚生労働大臣表彰を受賞。(24/7)
- 富山事業所がRBAのVAP監査で最高評価のプラチナ・ステータスを取得。(24/6)
- 地域貢献活動の一環として保育所施設で青空環境教室を実施。(24/5)
- 「WOMEN IN SEMICONDUCTORS – WIS」で当社グループ会社従業員がゲストプレゼンテーションを実施。(24/5)
- 富山県砺波市で開催された「2024となみチューリップフェア」に協賛。(24/4)



©(公社)とやま観光推進機構



富山事業所が拠点を構える富山市八尾町で開催される  
おわら風の盆に協賛



「とやま女性活躍企業」の認定マーク



献血運動推進協力団体厚生労働大臣表彰を受賞

# 用語集

- バッチ成膜装置：多数のウェーハを一括処理するバッチ方式により成膜を行う装置
- トリートメント装置：ウェーハを1枚単位で処理する枚葉方式により成膜後の膜質を改善する装置
- ALD: Atomic Layer Depositionの略  
当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます
- CVD: Chemical Vapor Depositionの略
- CFET: Complimentary Field Effect Transistorの略
- FinFET: Fin Field Effect Transistorの略
- GAA: Gate All Aroundの略
- HBM: High Bandwidth Memoryの略
- POR : Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す
- TAM: Total Addressable Marketの略
- VCT: Vertical Channel Transistorの略
- WFE : Wafer Fab Equipmentの略

